電波新聞　記事掲載　2013年1月16日（水曜日）付

千住金属工業

新製品「M47」

信頼性高めた低銀はんだ

新たな添加物で界面強化図る

千住金属工業は、10年にずマイグレーションを防止「紛争フリー宣言」をしておるやに入りはんだおり、コンゴ周辺諸国のスROS、パワー半導体実装ズを使用しない目的や用途に放熱性を向上させるNiに合わせた各種はんだ材料ボール入りソルダープリフと、省エネ／省スペースリォームHQ、モバイル機器フロー炉やフローはんだ付ソリューションとして新O

また、6テーマのプレゼンテーションを20分間隔で繰り返して実施する。

この中で「M47」は、新たな添加物で界面強化を図り、信頼性を高めた低銀はんだの新製品。

低銀化は低価格を実現するが、同時に耐熱疲労特性を低下させる問題が生じる。同社はBi（ビスマス）やIn（インジウム）などの添加による固溶強化によるO・3%Ag（銀）の「M46」を開発し、この問題を解決してきた。しかし、M46は固溶強化によってはんだバルク自体が非常に強固となったため、部品構造によっては、応力が接合界面部に集中し破壊に至るモードが見られたことから、新たな添加物で界面強化を図り、信頼性の高い「O・3%Ag M47」を開発した。

「M47」は「M705」（3%Ag）はんだと同等以上の耐熱疲労性。温度上昇も一般的な3元系Sn（スズ）Ag（銀）Cu（銅）系低銀はんだよりも低く抑えた。「M46」よりもさらに低価格化。溶融温度のツインピークモードによるチップ立ちの抑制効果はM46を継承、優れたはんだ付け性を実現する。

・3%低銀ソルダーペーストM47、ボール接続用転写型ソルダーペーストNSV-320、微細接続用としてのφ0・1㍉ボールや入りはんだEFC、将来実現するO201部品の接合を可能とするPPSを展示。EFCは、はんだ付け体験コーナーで体験できる。

千住金属工業の「M47」

電装とモバイル機器ソリューションにフォーカスしたはんだ材料を展示する。

電装ソリューションとして、耐熱疲労特性に優れたM53、はんだ量の不足するスルーホール部への補強に3216型チップソルダー、フラックス残渣が割れ付け装置を展示する。

国際カーエレクトロニクス技術展 ブース見どころ／事業戦略